

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2022-044

江苏大港股份有限公司

关于控股孙公司投资建设 12 吋 CIS 芯片 TSV 晶圆级封装项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股孙公司投资建设12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目的议案》，具体内容公告如下：

一、投资概述

因经营和发展的需要，公司控股孙公司苏州科阳半导体有限公司（以下简称“苏州科阳”）拟使用自筹资金投资建设12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目，产能6,000片/月，预计总投资约4.24亿元。

公司于2022年8月25日召开第八届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股孙公司投资建设12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目的议案》。上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，上述事项需提交公司股东大会审议。

二、项目公司的基本情况

- 1、名称：苏州科阳半导体有限公司
- 2、注册资本：25,483 万元人民币
- 3、成立日期：2010 年 7 月 6 日
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、注册地点：苏州市漕湖街道方桥路 568 号
- 6、法定代表人：王靖宇

7、统一社会信用代码：91320507558061590Y

8、经营范围：半导体集成电路产品的设计、研发、制造及封装测试服务，生产、销售发光二极管，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股东及出资情况：

| 股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 持股比例 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------|
| 江苏科力半导体有限公司 | 12,996.5802 | 12,996.5802 | 51.00% |
| 周芝福 | 467.3839 | 467.3839 | 1.83% |
| 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 | 3,295.0519 | 3,295.0519 | 12.93% |
| 惠州东宏升投资发展合伙企业 (有限合伙) | 163.5893 | 163.5893 | 0.64% |
| 惠州智通津元企业管理咨询合 伙企业(有限合伙) | 37.3947 | 37.3947 | 0.15% |
| 苏州科芯集成管理咨询合伙企 业(有限合伙) | 3,025.6266 | 3,025.6266 | 11.87% |
| 苏州龙驹创合创业投资合伙企 业(有限合伙) | 1,487.9867 | 1,487.9867 | 5.84% |
| 苏州龙驹智芯创业投资合伙企 业(有限合伙) | 4,009.3867 | 4,009.3867 | 15.73% |
| 合计 | 25,483.00 | 25,483.00 | 100% |

公司持有江苏科力半导体有限公司 95%股权，江苏科力半导体有限公司持有苏州科阳 51%股权，苏州科阳为公司控股孙公司。

10、经营情况及财务状况：

单位：万元

| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|-------|------------|-------------|
| 资产总额 | 53,011.31 | 50,792.52 |
| 负债总额 | 14,062.64 | 12,214.38 |
| 净资产 | 38,948.67 | 38,578.13 |
| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 |
| 营业总收入 | 8,587.31 | 25,049.87 |

| | | |
|---------------|--------|----------|
| 利润总额 | 383.69 | 4,669.12 |
| 净利润 | 370.54 | 4,230.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 922.46 | 4,320.60 |

注：上述2021年度数据已经审计，2022年半年度数据未经审计。

三、项目基本情况

1、项目名称：12吋 CIS 芯片 TSV 晶圆级封装项目

2、承办单位：苏州科阳半导体有限公司

3、建设地点：苏州市漕湖街道方桥路 568 号

4、建设内容：本项目是在目前苏州科阳拥有的 8 吋 TSV 晶圆级封装产线技术、工艺基础上，面向 CIS 传感器及模组小型化、智能化、低功耗化的发展方向，提供更丰富的芯片晶圆级封装及模组整合制造服务，主动应对市场情况、客户需求等要素环境变更，主要利用现有厂房部分搬迁改造，新增设备及附属设施，建设 12 吋 TSV 晶圆级封装产能 6,000 片/月，项目分两步实施，合计总投资约 42,400 万元，其中第一步需投资约 31,900 万元，新建 12 吋车间及封装产能 3,000 片/月，第二步投资约 10,500 万元，再扩建 12 吋封装产能 3,000 片/月，扩产完成后可实现 12 吋 TSV 晶圆级封装产能 6,000 片/月。

5、建设期：项目建设期共两年，采用分步分期的方式进行建设，第一年完成首期 3,000 片/月产线建设；第二年完成扩产 3,000 片/月产线建设。

6、项目投资估算：项目总投资 42,400 万元，主要用于厂房改造、购置设备及附属设施。通过效益分析，预计 7 年左右可收回投资成本。

7、资金来源：本项目投资所需资金由苏州科阳自筹，一是利用企业自有资金和银行贷款，二是后续增资扩股引进战略投资者获得的增资款。

四、项目投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、目的

苏州科阳目前是以 8 吋 TSV 晶圆级封装业务为主，而客户的核心产品和供应体系正在向 12 吋转移，为迎合市场发展趋势和客户发展要求，苏州科阳拟投资新建 6,000 片/月 12 吋 TSV 晶圆级封装产线，形成“8 吋+12 吋”搭配产能和销售，从而提高行业竞争力和对客户的服务能力，实现自身的持续健康发展。

2、对公司的影响

苏州科阳投资建设 12 吋 TSV 晶圆级封装项目，有利于提升集成电路高端封装水平、扩大产能规模，快速响应客户需求，提升其产品市场份额、行业地位和竞争优势，吸引高级技术和管理人才。项目投资所需资金由苏州科阳自行筹措，不会对公司现金流产生重大影响。

3、存在的风险

1) 项目建设风险：项目的建设周期和进程等因素，导致本项目达产日期存在一定的不确定性。

2) 技术研发风险：封装企业接单生产前均需经过一定时间的客户导入期，如果不能按照客户需求完成技术开发和产品良率提升，将会造成战略客户流失，影响项目开展。

3) 专业人才流失风险：近年来，国内集成电路产业从业人员数量持续快速增长，行业人才资源整体较之前得到缓解，但高层次人才依然紧缺，特别是有经验的行业专家和应用技术研发人才严重不足。半导体企业依然面临着高层次专业技术人才紧缺和流失的风险

五、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十七日